

ASICLAND



회사소개자료

The background of the slide is a dark blue circuit board with glowing blue lines and nodes. The word "ASICLAND" is written in a bold, white, sans-serif font, centered horizontally and partially overlaid by a dark blue rectangular bar.

ASICLAND

Contents

- I. 회사소개
- II. 사업영역
- III. 핵심경쟁력

I.회사소개

1. 회사개요
2. 회사연혁
3. 대표이사 Profile
4. 조직도
5. 경영성과

I. 회사소개

1. 회사개요

ASICLAND

Dream with ASICLAND

ASICLAND



Mission

인재육성과 끝없는 도전을 통해 IT산업의 가치창조에 기여



Vision

글로벌 ASIC Service Company
기술 경쟁력을 갖춘 일하기 좋은 Company

I. 회사소개

1. 회사개요

ASICLAND

ASICLAND

회사명

주식회사 에이직랜드 (ASICLAND Co., Ltd.)

설립일

2016년 4월 5일

대표이사

이종민

주요사업

주문형 반도체 디자인 서비스 (ASIC Design Service)
시스템 온 칩 제품 개발 (SoC Design Service) / FPGA 보드제품 개발

종업원수

60명 (연구소 42명 (70%))

소재지

경기도 수원시 영통구 대학로 60, 309호 (리치프라자 3차)

연락처

Tel. 031-212-1984 / Fax. 031-212-1985

홈페이지

www.asicland.com

1. 회사소개

2. 연혁

- (주)에이직랜드 기업부설 연구소 인증 (한국산업기술진흥협회)
- 반도체산업협회 가입

- TSMC VCA 계약 체결(2019/06)
- 경기도 유망 중소기업 선정 (경기도)
- 일자리 우수 기업
- 성과공유형 중소기업

2016

2017

2018

2019

2020

- 주식회사 에이직랜드 법인 설립
- 벤처기업 지정
- 광운대학교 산업협력단 상호 협력 협약 체결 (광운대 산업협력단)

- ISO 9001:2015 인증
- ARM ADP (Approved Design Partner) 지정
- 가족친화우수기업 (여성가족부)
- 인재육성형 중소기업 (중소벤처기업부)
- 일백만불 수출의 탑 수상 (한국무역협회)

- 소재, 부품, 장비 전문기업 확인
- Kibo - Star 기업 선정
- 기술평가 우수기업 인증 (인증등급: T-3)



ASICLAND

대표이사 이종민 (James Lee)

경력 2003 SK 하이닉스 반도체 연구원
2005 (주)버추얼다임 책임연구원 : SoC 개발팀
2009 (주)휴먼칩스 수석연구원 : AISC 개발팀
2012 (주)다윈텍 수석연구원 : ASIC 개발팀
2016 (주) 에이직랜드 대표이사

1. 회사소개

4. 조직도

ASICLAND



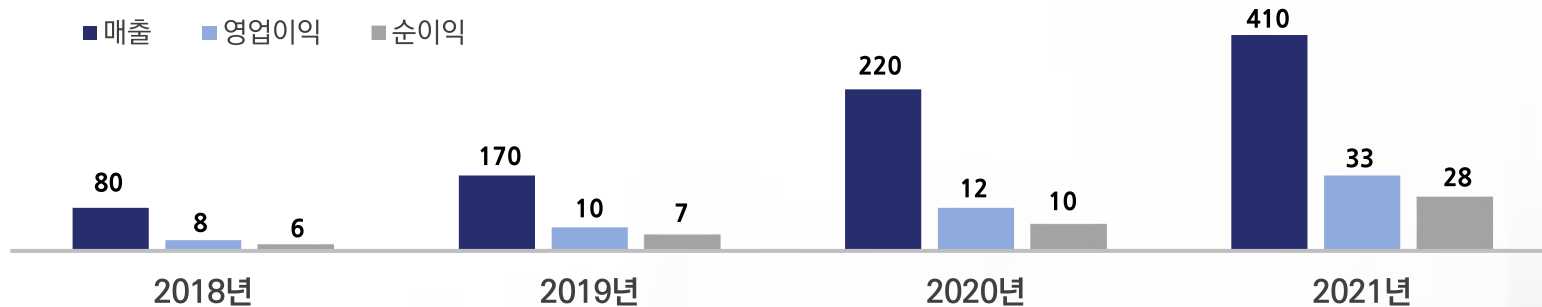
대표이사



1. 회사소개

5. 경영성과

(단위: 억원)



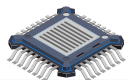
2018	2019	2020(F)	2021(F)
매출액성장률 60% ↑ 영업이익성장률 42% ↑ 당기순이익성장률 25% ↑	매출액성장률 112% ↑ 영업이익성장률 25% ↑ 당기순이익성장률 16% ↑	매출액성장률 30% ↑ 영업이익성장률 20% ↑ 당기순이익성장률 42% ↑	매출액성장률 86% ↑ 영업이익성장률 175% ↑ 당기순이익성장률 180% ↑

II. 사업영역

1. AISCLAND Business Area
2. SoC Business
3. Design Service Business
4. PA Business

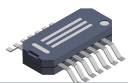
II. 사업영역

1. ASICLAND Business Area



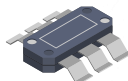
SoC Service

- 고객사/시장 Needs 충족을 위한 Total Design Solution
- Spec-in에서 부터 칩 설계 및 개발보드, F/W, OS포팅까지 개발 전반에 걸쳐 고객이 필요로 하는 부분의 서비스 제공



Design Service

- 고객사가 요청하는 Application에 맞게 합성부터 GDS Out까지 다양한 공정의 Design Service를 제공



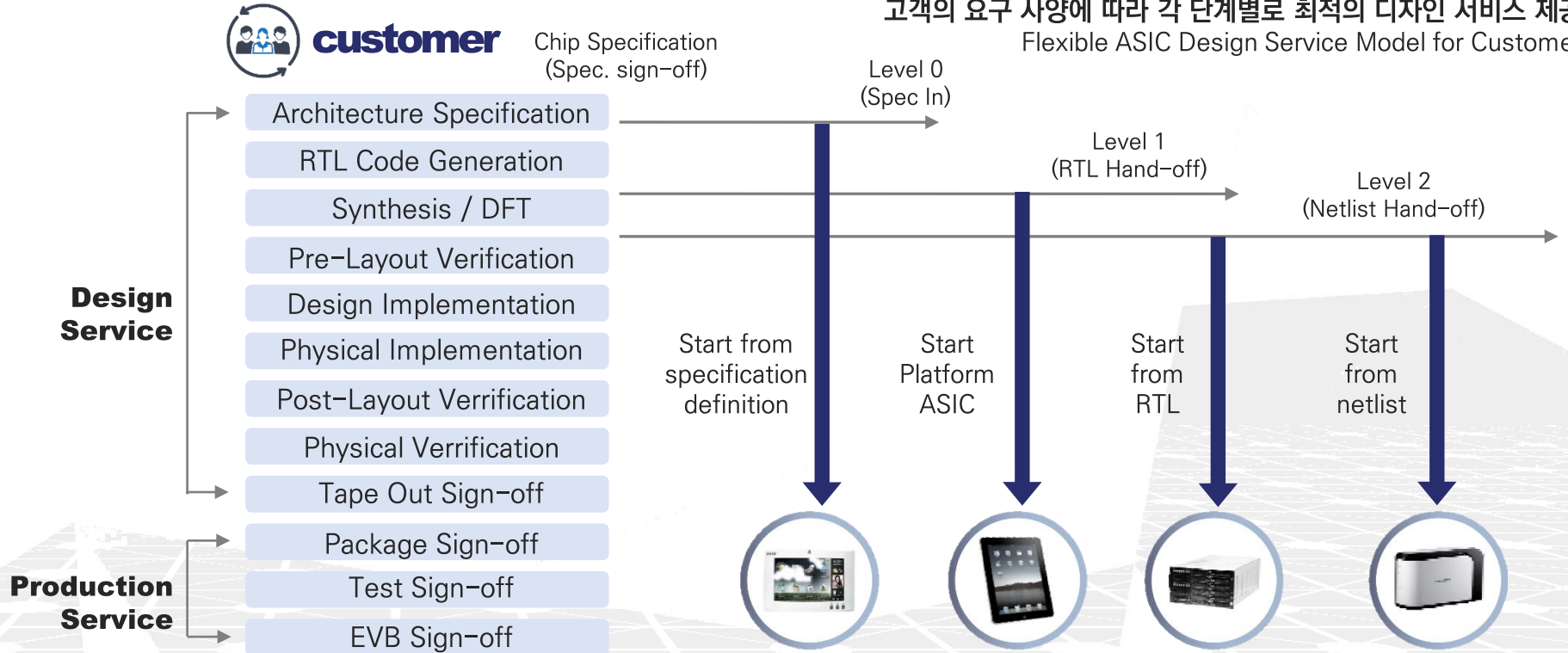
PA Service

- 고객사가 요청하는 Application에 맞게 IP 수배에서 후공정업체까지 관리
- 고객사의 소중한 제품을 대응하기 위한 Chip 제작의 전체적 Flow Service를 제공

II. 사업영역

1. ASICLAND Business Area

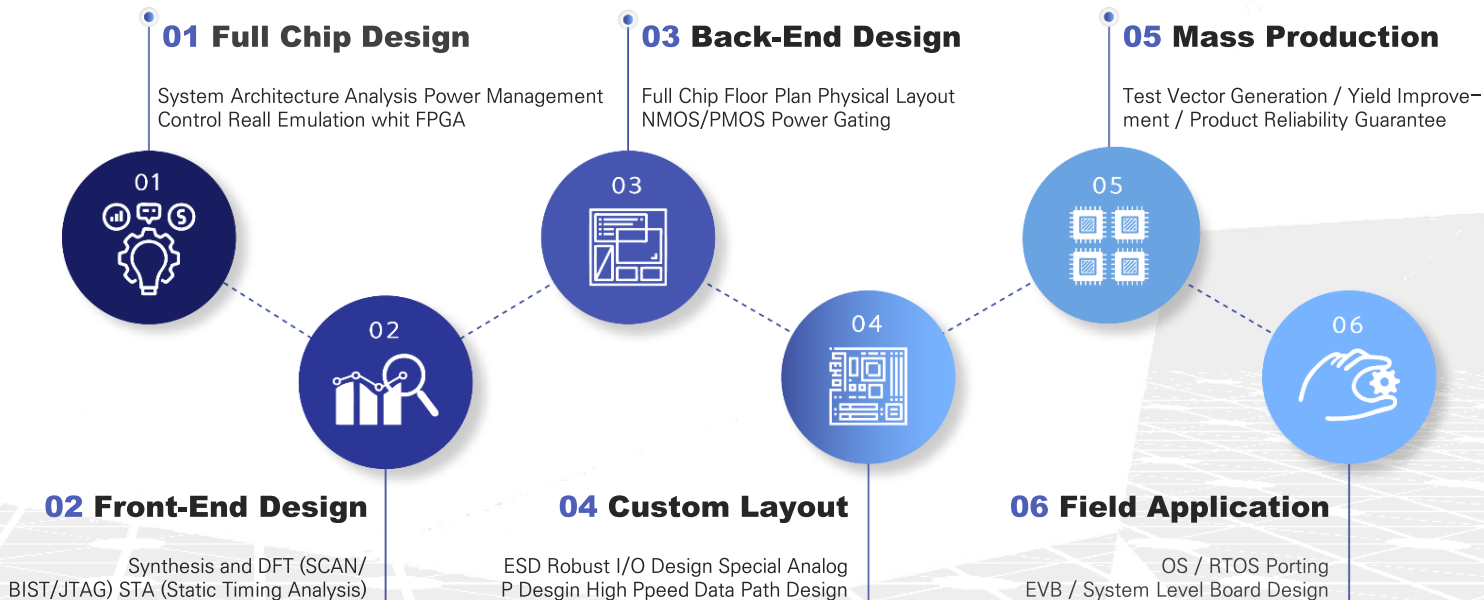
고객의 요구 사양에 따라 각 단계별로 최적의 디자인 서비스 제공
Flexible ASIC Design Service Model for Customer



II. 사업영역

1. ASICLAND Business Area

Provide solution & core technology from development to mass production



II. 사업영역

2. SoC Business

Spec-in	Platform Biz	Low power design	IP development	S/W+H/W Turnkey development
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Start form specification ✓ Start from RTL Design 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ARM ✓ HIS(High Speed interface) integration ✓ System peripheral 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Power/Clock gating ✓ Multi threshold voltage ✓ Multi supply voltage 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ User custom IP ✓ Image processing component 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Board level design ✓ BSP/SDK design

✔ **System Team**

- Foundry Tech 기반 Top설계
- Clock, Reset Top 설계
- IO MUX 설계 및 digital pad 적용
- CPU 및 High Speed Interface Integration & regression

✔ **Solution Team**

- OS(Linux / Android) Portion
- RTOS, F/W 설계
- BSP, SDK 제작
- Evaluation Board 설계

✔ **Platform Team**

- ARM 기반 CPU Platform 설계
- Cortex-A Series, Cortex-R Series
- Cortex-M Series Platform 설계

II. 사업영역

3. Design Business

<p>Spec to GDS RTL to GDS Netlist GDS</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Start form specification ✓ Start from RTL Design 	<p>DFT(DesignForTest)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sacn - ATPG - Jtag - Memory BIST/BIRA
<p>Hard IP(GDS)merge</p>	<p>Auto P&R</p>
<p>Digital IP Hardening</p>	<p>Chip Test</p>



II. 사업영역

4. PA Business

Project management(PM)

- ✓ Design Service(DS)&ASIC Service(ASIC)
Schedule Management&Project sign off

IP Survey

- ✓ Customer Design Spec based
on IP survey
- ✓ Develop Customized IP per
customer need

TSMC Technical Support

- ✓ Customer Technical Support
- ✓ PDK (Process Design Kit)
Management & Support
- ✓ TSMC TapeOut support

Package(PKG) Service

- ✓ Customer PKG Design Support
- ✓ PKG Schedule Management

Test Service

- ✓ Wafer level circuit probing(CP) and
Package level test (FT)
- ✓ ASICLAND's qualified testing partners
run the testing program

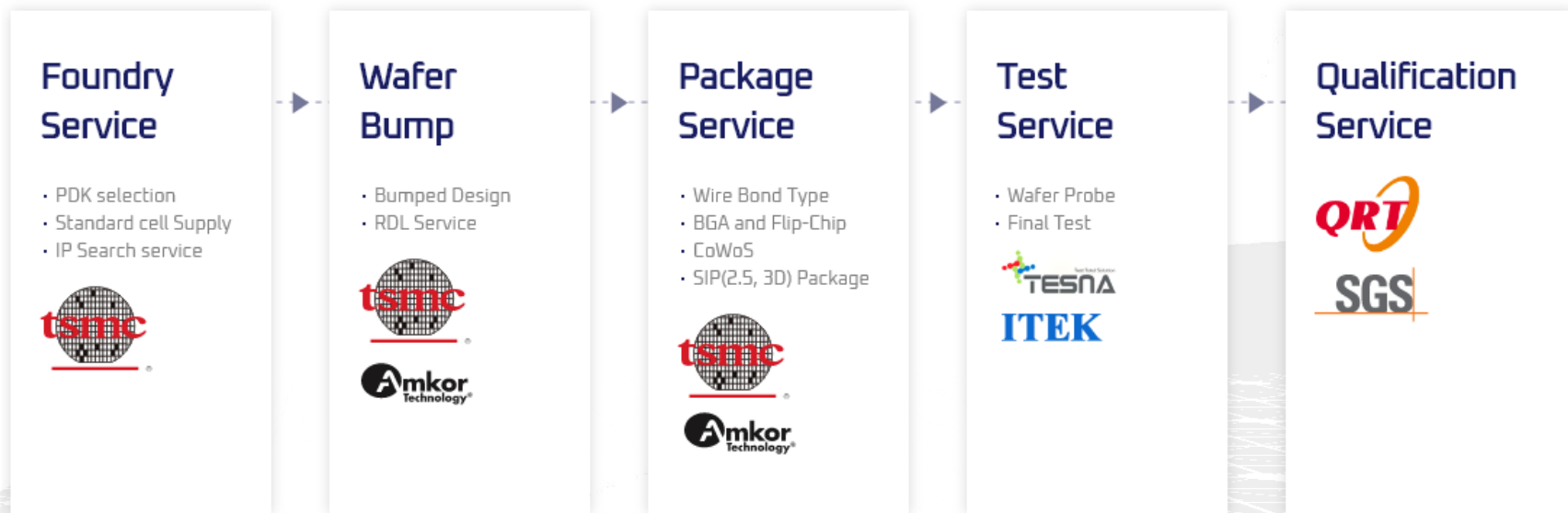
Failure Analysis&Reliability Service

- ✓ Support FA solutions for RMA
and Defect identification
- ✓ Support reliability qualification
services

II. 사업영역

4. PA Business

ASICLAND



Ⅲ. 핵심경쟁력

1. 차별화된 강점
2. 우수설계 인력
3. 개발과제 실적

III. 핵심경쟁력

1. 차별화된 강점

Chipless(칩리스) – Full Turnkey 방식의 반도체 개발이 가능한 회사

- ✓ Specification, Architecture Design, EVB Design
- ✓ 타 설계업체와 달리 제품의 개발에서 시제품생산 및 양산 공급까지 진행 중 ⇨ AI, IoT, CPU Sub-system

VCA – 글로벌 NO.1 파운드리 TSMC의 VCA (Value Chain Aggregator)

- ✓ 국내 유일한 TSMC의 VCA (글로벌 8개사)

AADP – ARM ADP(Approved Design Partner)로 지정된 글로벌 회사

- ✓ 영국 ARM사의 ARM CPU Based Design 설계 능력 인증

기술 UP, 삶의 만족도 UP – 안정적이며, 직원들이 일하기 좋은 회사

- ✓ 우수기술 인증 기업, 가족친화 중소기업, 인재육성 우수기업, 성과공유형 중소기업
- ✓ 경기도 유망 중소기업, 일자리 우수 기업 및 일하기 좋은 기업으로 선정

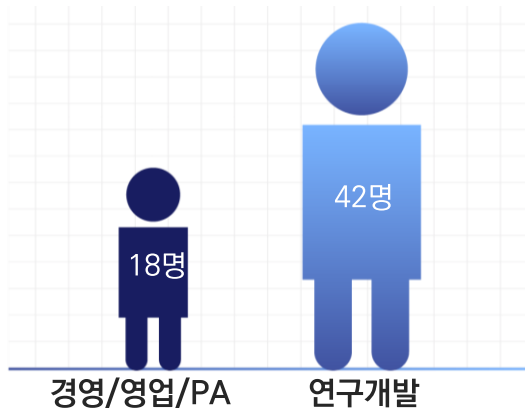
축적된 기술 Know-how와 개발 경험이 풍부한 우수 인재가 모여 있는 회사

- ✓ 검증된 기술력과 Know-how 를 가진 설계 경력 10년 이상의 특급 연구인력 다수 보유
- ✓ TSMC 7nm 설계 진행, 12nm 국내 최대 과제 수행

III. 핵심경쟁력

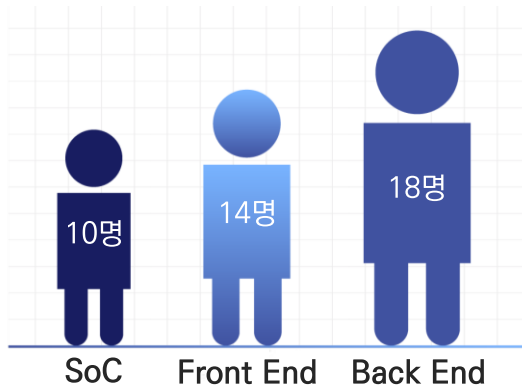
2. 우수한 설계 인력

인력구성



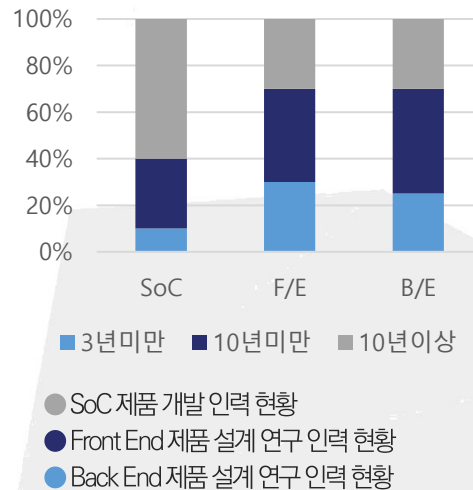
· 연구개발인력 비율 (70%)

업무별 연구인력 구성



- SoC 인력 (24%)
- Front End 인력 (33%)
- Back End 인력 (43%)

경력별 / 직군별 인력 분포



감사합니다.

(주)에이직랜드